



# 美格智能 SRM810 模组

5G NR LGA封装小尺寸全功能模组

美格智能5G模组SRM810模组是一款专为IoT/电力/eMBB等应用而设计的国产化5G Sub-6GHz模组,该模组采用LGA封装,尺寸为30.0x41.0x2.7mm,采用了紫光展锐唐古拉V510国产芯片方案,符合3GPP Release 15标准,可支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,支持国内所有运营商频段需求,并向下兼容4G/3G网络,可为国内客户带来更完美的5G体验。

SRM810模组提供丰富的功能接口方便用户进行外设扩展,可支持USB3.0、PCIe2.0、SDIO、SPI、多路UART、ADC、GPIO等接口,内部预留eSIM支持;可适配多种类型操作系统(Android, Linux, Windows等),同时内置了丰富的网络协议,在尺寸、可靠性、散热等方面有较大优势,可广泛应用于eMBB、电力、工业互联网、智慧医疗、智慧城市等垂直行业。

## 主要优势:

- ▣ 超小尺寸,全功能,4天线极简设计
- ▣ 国产芯片及射频方案,高性能和高性价比
- ▣ 支持国内四大运营商,支持双卡功能
- ▣ 支持USB3.0、PCIe2.0、SDIO等高速接口
- ▣ 符合3GPP Release 15标准,支持SA&NSA,向下兼容4G/3G



5G NR



SA&NSA



LGA封装



USB3.0



PCIe 2.0



MIMO



-40°C-85°C



VoNR/VoLTE\*

# MeiG Smart SRM810模组

5G NR LGA封装小尺寸全功能模组

MEIG 美格

股票代码:002881

## 基本属性:

- 封装: LGA封装
- 尺寸: 30.0×41.0×2.7mm
- 重量: <10g

## 模组速率:

- 5G NR Sub-6GHz:
  - MIMO 4\*4, 256QAM
  - Downlink up to 2.0Gbps
  - Uplink up to 900Mbps
- LTE:
  - Downlink up to 400Mbps
  - Uplink up to 150Mbps
- DC-HSPA+:
  - Downlink up to 42.4Mbps
  - Uplink up to 5.76Mbps

## 驱动&工具:

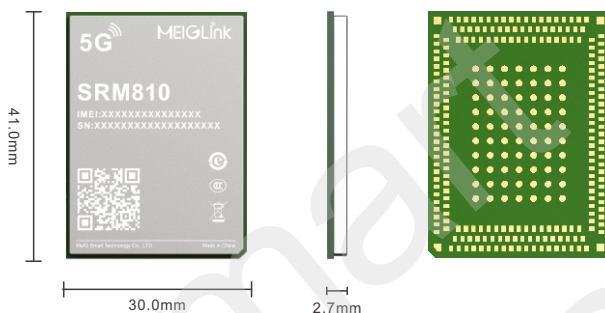
- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 图形化升级工具, 多系统下日志工具
- USB升级, FOTA升级

## 模组接口:

- 1xUSB 2.0/USB 3.0
- 1xPCIe Gen2.0
- 2xUART
- 1xSDIO 3.0
- 2xSIM卡接口(1.8 / 3.0V)
- eSIM
- 天线接口: 主/分集/MIMO天线, 共4根
- 1xSPI
- 1xI2C
- GPIOs

## 认证信息:

- CCC\*/SRRC\*/CTA\*



## 发射功率:

- Class 2 for N41/N78/N79
- Class 3 for LTE-FDD
- Class 3 for LTE-TDD

## 网络协议:

- RNDIS/NCM/IPv4/IPv6/TCP/UDP

## 环境温度湿度特性:

- 正常工作温度: -30°C to 75°C
- 扩展工作温度: -40°C to 85°C
- 存储温度: -40°C to 90°C
- 湿度: 5%~95%

## SRM810系列频段信息:

5G NR NSA: N41/N78/N79  
5G NR SA: N1/N8/N28/N41/N78/N79  
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8  
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41  
WCDMA: B1/B8  
5G DL 4x4 MIMO: N41/N78/N79

备注: \* 研发中

